

## NOTA DE PRENSA

### **PACKNET LLEVA A DEBATE EL CAMINO HACIA LA CIRCULARIDAD DEL PACKAGING EN SU JORNADA PRESENCIAL ORGANIZADA EN COLABORACIÓN CON HISPACK**

*La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje (Packnet) en colaboración con HISPACK organizó una Jornada presencial el día 12 de marzo, en horario de 09.30 a.m. a 14.00 a.m. en el Colegio Tajamar (Madrid).*

#### **13 de marzo de 2024.**

El pasado 12 de marzo, PACKNET, en colaboración con HISPACK, organizó una jornada presencial en el Colegio Tajamar (Madrid). En esta ocasión orientada a la circularidad en el packaging y su recorrido hacia un futuro sostenible, cuestión que abordaron las tres Mesas Redondas integradas por profesionales del sector pertenecientes a entidades socias de la Plataforma, los cuales brindaron sus ópticas para analizar y desarrollar las cuestiones planteadas.

#### **“Necesidad de aplicar un enfoque global de la eco innovación como vector de la circularidad”**

La primera Mesa Redonda tuvo inicio a las 10.10h e Ignasi Cusí (Director General en GRAPHISPACK) actuó de moderador entre las entidades participantes, representadas por sus ponentes: María Segura (Responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente en ACES), Joaquín Fernández (Director de Desarrollo Estratégico en AFCO), Paula Cinto (Gerente de Asuntos Públicos en ECOVIDRIO), Marga Romo (Responsable de Marketing en MM NEKICESA) contrapuso, Pablo Narváz (Cadena de Custodia y Desarrollo de Marca en PEFC) y Josu García (Responsable de Sostenibilidad en ULMA PACKAGING). Durante las intervenciones se evaluaron plazos, se definieron los mayores desafíos operativos, las influencias de realidades de consumo, la inteligencia artificial como herramienta, estrategias de optimización e iniciativas que se están implementando.

#### **“Escenarios a futuro de la reutilización de los envases y embalajes: retos y oportunidades derivadas”**

La Mesa Redonda del ecuador de la jornada fue moderada por Juan Ramón Meléndez (Director General Asociación LATAS DE BEBIDAS). Se contó con las intervenciones de Juan Ros (Director de Proyectos y Desarrollo en AEVAE), Concha Bosch (Tecnologías de Envase en AINIA), María Martínez-Herrera (Directora de Sostenibilidad en ASEDAS), Jose María Carrasco (CEO y CFO Iberia en CARTONPLAST), Tinixara Mesa (Coordinadora Cuentas Grandes en ECOEMBES) y Aitor Peña (Head of Marketing & PR en VIDRALA). Los profesionales se adentraron en cuestiones como la manera de afrontar el inestable clima

económico de cara al suministro de materias primas, modelos específicos que se están desarrollando para adaptarse al cambio legislativo, infraestructuras necesarias para facilitar sistemas de reutilización, los cambios que se esperan o medidas ya implementadas.

Tras su finalización, y poniendo rumbo a la recta final de la jornada, tomaba inicio la tercera y última de las Mesas Redondas.

## “Avances y tecnologías de reciclado que faciliten la transición hacia la economía circular en materia de envases y embalajes”

La Mesa estuvo moderada por Belén García (Directora de PACKNET) e integrada por Luis Palomino (Secretario General en ASEGRE), Nicolás Molina (Director Técnico en FER-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN), Miriam Lorenzo (Jefa de Proyectos en el Área Tecnológica de Reciclado y Valorización de Residuos en ITENE), Irene Mora (Responsable de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en PLASTICS EUROPE), Carmen Sánchez (Directora General en PROCIRCULAR) y Víctor Borrás (CCO en KNAUF INDUSTRIES). Los ponentes indagaron en aspectos tales como los obstáculos que se identifican a la hora de cumplir plazos, la innovación tecnológica como factor determinante, anticipaciones, definición de las tecnologías más vanguardistas, participación en nuevos convenios, el papel del ciudadano o propuestas de materias primas alternativas.

Tras la finalización de la tercera Mesa Redonda, se dio por concluida la jornada. Sin lugar a duda, una jornada donde la sinergia entre los líderes de la industria y expertos se tradujo en un intercambio de ideas transformador. No solo se contribuyó al entendimiento de los desafíos en el marco del envase y embalaje, sino que también se consolidó una base donde apoyarse para el desarrollo a futuro de la industria. Un evento que actuó de punto de encuentro entre profesionales, pero, sobre todo, de catalizador para la innovación.

PACKNET es la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje, constituida como una red española de cooperación científica y tecnológica, al amparo de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación. Se conforma como un foro abierto de trabajo multidisciplinar, liderado por las empresas y sus organizaciones empresariales, que cuenta con el soporte de los centros tecnológicos, organismos de investigación y universidades, abierta a la participación de todas las entidades y empresas con intereses en el ámbito de la cadena de valor del envase y el embalaje.

El objetivo de la Plataforma es dar una respuesta estratégica conjunta al sector del envase y el embalaje, y crear un espacio común donde intercambiar conocimientos, aunar esfuerzos e impulsar la I+D+i en el sector del Packaging.

[comunicación@packnet.es](mailto:comunicación@packnet.es)

[Packnet - Plataforma Tecnológica Española del Envase y Embalaje](#)